



実装材料の開発を担当されている方
パワーデバイスの開発を担当されている方
パワーデバイスの熱設計を担当されている方
その他本テーマに関心のある方

KISTEC職員による
対面実習付き研修

パワーモジュールの実装評価

令和6年2月21日(水)13:15~17:00

近年、パワーモジュールの実装技術は以下のような方向性で開発が進められています。

- ①小型化・軽量化【低熱抵抗化が必要(高放熱・高効率冷却技術)】
- ②高耐熱化【樹脂や接合材料などの実装材料の高耐熱化】
- ③高周波化【配線抵抗(インピーダンス)の低減】
- ④高信頼性【特に高Tjのパワーサイクル耐久性が求められる】

熱抵抗測定はこのうち①に直接、②④に間接的にかかわります。

この研修はパワーモジュールの実装技術のうち評価技術の紹介を目的として、主に熱抵抗測定の実習を中心に進めていきます。

受講料

12,000円(税込、テキスト代込)

定員

5名(先着順)

実施会場

KISTEC海老名本部

申込締切日

令和6年1月29日(月)

詳細・申込はHPをご覧ください



カリキュラム

パワーモジュールの実装評価法や、熱過渡解析の構造関数の使い方が理解できる

13:15~14:15 パワーモジュールの評価設備【講義】

14:25~15:15 熱抵抗測定と熱過渡解析【講義】

15:30~16:45 熱抵抗測定と熱過渡解析【実習】

16:50~17:00 質疑応答

▼お問合せ

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) 人材育成部 教育研修課 産業人材研修G
TEL 046-236-1500 E-mail sm_sangyoujinzai@kistec.jp